

Действительно, входной сигнал в П. т. подаётся на затвор, сопротивление к-рого в П. т. с управляющим $p-p$ -переходом и ПТШ определяется сопротивлением обратно смещённого $p-p$ -перехода или сопротивлением барьера Шоттки, а в МДП-транзисторе — сопротивлением слоя диэлектрика. Величина $R_{\text{вх}}$ в П. т. обычно превосходит $10^8 \Omega$, в нек-рых конструкциях достигает $10^{14} \Omega$. Входное сопротивление по первому току практически определяется ёмкостью затвора $C_{\text{вх}}$.

В сверхвысокочастотных П. т. величина $C_{\text{вх}} < 1 \text{ пФ}$, в мощных низкочастотных П. т. величина $C_{\text{вх}} \gtrsim 100 \text{ пФ}$. Усилит. свойства П. т. характеризуются крутизной вольт-амперной характеристики S , определяемой как отношение изменения тока между истоком и стоком (тока стока) ΔI_c к изменению напряжения на затворе ΔU_g при пост. напряжении на стоке:

$$S = \frac{\Delta I_c}{\Delta U_g} \Big|_{U_c=\text{const}}.$$

При неизменной структуре прибора крутизна растёт прямо пропорционально ширине затвора B (рис. 5). Поэтому при сравнении усилит. свойств разл. типов П. т. используется понятие уд. крутизны S^* (отношения крутизны к ширине затвора B). Крутизна П. т.

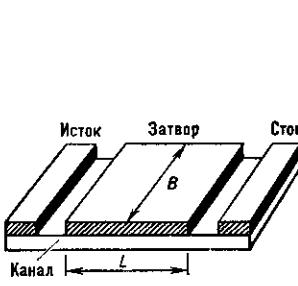


Рис. 5.

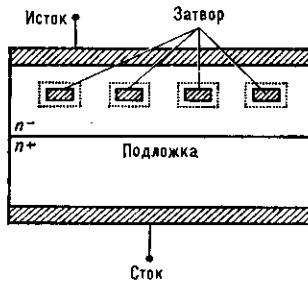


Рис. 6.

измеряется в сименсах, уд. крутизна — в сименсах/мм. В серийных П. т. $S^* \approx 0,05-0,2 \text{ См}/\text{мм}$. В лаб. разработках достигнуты значения $S^* \approx 1,2 \text{ См}/\text{мм}$ при 300 K и $\approx 2 \text{ См}/\text{мм}$ при 77 K .

П. т. относятся к малопшумящим приборам. Типичное значение коэф. шума (см. *Шумовая температура*) серийных П. т. $K_{\text{ш}} \approx 1-3 \text{ дБ}$. Предельные ВЧ-свойства П. т. определяются временем пролёта носителей под затвором t_p вдоль канала. Макс. рабочая частота П. т. может быть оценена, как $f_{\text{макс}} \sim 1/t_p \sim v_{\text{макс}}/L$, где L — длина затвора (рис. 5). Величина L в серийных П. т. составляет $0,5-10 \text{ мкм}$. В лаб. условиях широко исследуются приборы с $L \approx 0,1-0,25 \text{ мкм}$. Величина $v_{\text{макс}}$ в кремниевых приборах не превосходит дрейфовой скорости насыщения $v_s \sim 1 \cdot 10^7 \text{ см}/\text{с}$ (см. *Лавинно-пролётный диод*). В П. т. на основе соединений Al^3V при $L \leq 0,5 \text{ мкм}$ важную роль играют т. н. баллистич. эффекты (движение носителей заряда без столкновений на длине канала), за счёт к-рых величина $v_{\text{макс}}$ возрастает до $(4-6) \cdot 10^7 \text{ см}/\text{с}$. Предельная частота генерации П. т. превосходит 200 ГГц . Предельно малое время переключения П. т. $\sim 5 \text{ пс}$.

Оси. разновидности П. т. По областям применения все П. т. можно условно разбить на 4 осн. группы: П. т. для цифровых устройств и интегральных схем (ЦУ и ИС), П. т. общего применения, сверхвысокочастотные П. т. и мощные П. т.

П. т., предназначенные для работы в ЦУ и ИС, должны обладать малыми габаритами, высокой скоростью переключения и мин. энергией переключения. Серийные П. т. для ЦУ и ИС в наст. время изготавливаются в осн. из Si и характеризуются следующими параметрами: длина затвора $\sim 1 \text{ мкм}$, время переключения $\sim 1 \text{ нс}$, энергия переключения $\sim 1 \text{ пДж}$. Лучшие результаты получены с использованием П. т. на основе гетероструктур с селективным легированием (ГСЛ) [3, 4]. В ГСЛ-

транзисторах, называемых также транзисторами с высокой подвижностью электронов (ВПЭТ), используются свойства двумерного электронного газа, образующегося в нек-рых гетероструктурах на границе узконаправленного и широкозонного слоёв гетеропары. С использованием гетеропары $\text{GaAlAs}/\text{GaAs}$ получены ГСЛ-транзисторы с временем переключения 5 пс и энергией переключения $\sim 2,0 \cdot 10^{-14} \text{ Дж}$. Исследуются также ГСЛ-транзисторы с использованием др. гетеропар на основе соединений Al^3V .

Осн. требование к сверхвысокочастотным П. т. состоит в достижении макс. мощности или коэф. усиления на предельно высокой частоте. Продвижение в область высоких частот требует уменьшения длины затвора и макс. использования баллистич. эффектов для достижения высокой скорости носителей. Для изготовления сверхвысокочастотных П. т. в наст. время используется в осн. GaAs, в к-ром баллистич. превышение скорости над максимально возможным равновесным значением выражено значительно сильнее, чем в Si. Серийные СВЧ П. т. работают на частотах до $\sim 40 \text{ ГГц}$. Лаб. разработки проводятся на частотах $90-110 \text{ ГГц}$. Предельная частота генерации (230 ГГц) получена в ГСЛ-транзисторах на основе $\text{GaAs}/\text{InGaAs}$, изготовленных с помощью молекулярно-пучковой эпитаксии.

Мощные П. т. работают при напряжении в цепи канала $\sim 10^8 \text{ В}$ и коммутируемом токе $\sim 10 \text{ А}$. Т. к. мощность на единицу рабочей площади структуры принципиально ограничена необходимостью отводить тепло, мощные П. т. имеют большую общую длину электродов. Часто используется встречно-штыревая система электродов [2]. Мощные П. т. изготавливаются на основе Si и GaAs. Характерные рабочие частоты мощных П. т. достигают величин $\sim 10^3 \text{ МГц}$.

Новые разновидности П. т. Транзисторы с проинциализированной базой (ТПБ) предложены в 1979 и, по оценкам, способны, в принципе, повысить рабочую частоту П. т. до 10^{12} Гц (1 ТГц). Носители заряда в канале ТПБ движутся не вдоль поверхности полупроводниковой пленки, а перпендикулярно ей. Длина канала, и следовательно время пролёта носителей, в ТПБ могут быть значительно уменьшены в сравнении с планарным П. т. При планарной конструкции мин. размер затвора L определяется возможностями рентг. или электронно-лучевой микролитографии: $L \gtrsim 0,1 \text{ мкм}$ (1000 \AA). Предельно малая величина L в ТПБ определяется толщиной пленки, к-рая может быть получена в совр. установке молекулярно-пучковой эпитаксии, и составляет неск. атомных слоёв.

Электроны в ТПБ (рис. 6) движутся от истока к стоку в направлении, перпендикулярном поверхности пленки. Затвором служит металлич. сетка, «погруженная» в толщу полупроводниковой структуры ТПБ. По принципу действия ТПБ аналогичен ПТШ. Между металлич. сеткой и полупроводником возникает барьер Шоттки. Толщина обеднённой области вблизи проводников сетки определяется напряжением на затворе. Если толщина обеднённой области меньше расстояния между проводниками сетки, канал открыт и электроны свободно движутся к стоку. При достаточно большом напряжении обеднённые области перекрываются — канал закрыт. Осн. проблема создания ТПБ состоит в получении качественных границ раздела металл — полупроводник. ТПБ имеет большое сходство с электронной лампой, в к-рой управляющим электродом является металлич. сетка.

Др. разновидность П. т., в к-ром достигается уменьшение длины канала,

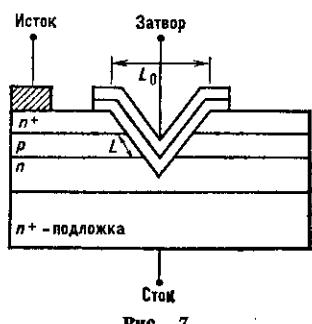


Рис. 7.